



鉛フリー対応 超低残さタイプ ポストフラックス

Low flux residue post flux, for lead-free solder

LCF-05



- 低残渣により外観良好
- ぬれ性／はんだ付け性向上

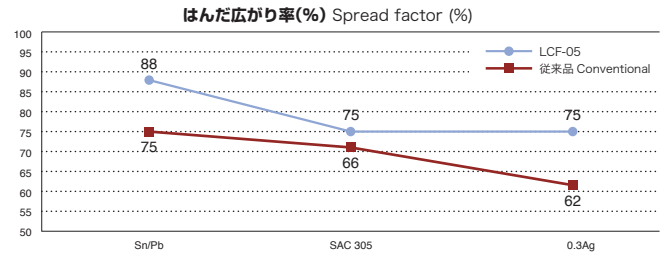
Clean appearance due to low flux residues
Improved wettability and solderability

外観 Appearance

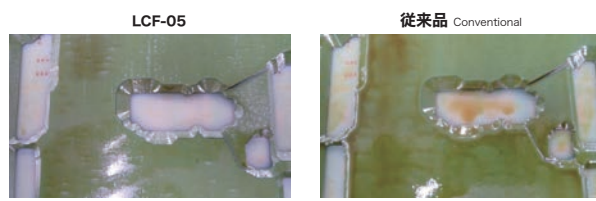


残渣は少なく、透明で均一 Low flux residues, transparent and even

ぬれ性 Wettability

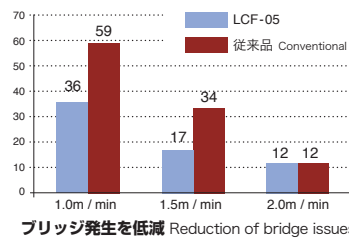


パレット治具のメンテナンス性 Maintenance and service of pallets and jigs



低残さ品につきパレット治具のメンテナンス性に優れる（弊社実験結果より）
Easy maintenance and service (Test internally)

はんだ付性 Solderability



評価条件 Test condition

吐出量 Application quantity	130ml/m ²
はんだ温度 Soldering temperature	255°C
予備加熱 Pre-heating	100°C
はんだ波 Solder wave	1次、2次波使用 1st and 2nd
コンベア速度 Conveyor speed	1.0, 1.5, 2.0m/min
はんだ組成 Alloy composition	Sn/Pb, 0.3Ag/0.7Cu

太陽電池向けタブ付け用 超低残渣ポストフラックス

Ultra low flux residue post flux for solar panels, tab application

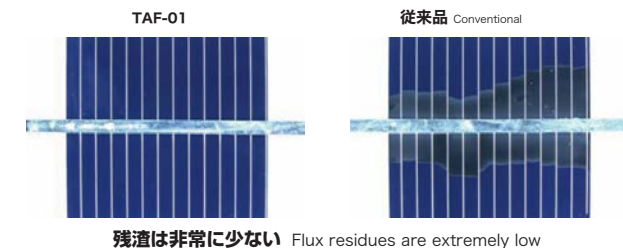
TAF-01



- 超低残渣により外観良好
- 高い接合強度

Excellent appearance by ultra low flux residues
High joint strength

特長 Appearance



残渣は非常に少ない Flux residues are extremely low

接合強度 Joint strength

接合強度 (N) [タブ線: Sn/Pb メッキ] Joint strength (mN) [Tab line: Sn/Pb plating]		
製品名 Product name	TAF-01	従来品 Conventional
試験項目 Test item		
タブ線引き剥がし強度 Peel strength	2.8	0.8

No.	特性項目 Properties	TAF-01
1	外観 Appearance	無色透明液状 Colour-less and transparent liquid
2	固形分含有量 (理論値) Solid content	1.6%
3	塩素含有量 Chlorine content	0.0
4	IPC 分類 IPC classification	OR L 0

No.	特性項目 Properties	TAF-01
5	ぬれ性 ゼロクロス時間 Wettability Zero crossing time(s)	2.2
6	ぬれ性 ぬれ作用力 Wettability Wetting force (mN)	2.4
7	銅板腐食 Copper corrosion	合格 Pass
8	絶縁抵抗値 (槽内測定) Insulation resistance (in the chamber) 85°C-85% RH 168h	1.8E+10